

Tube de 1.5g Pâte Thermique pour Dissipation Thermique d'Unité Centrale

StarTech ID: SILVGREASE1



Notre pâte thermique pour processeur améliore l'efficacité des refroidisseurs pour processeurs en thermoliant le processeur au puits thermique.

Cette solution métallique de haute qualité contribue à garantir une dissipation optimale de la chaleur générée par le processeur, à assurer ainsi de meilleures performances et à augmenter la stabilité du système. Cette solution est plus efficace que la pâte pour processeur ou la graisse thermique à base de silicone, offrant une meilleure protection contre les dégâts occasionnés par la chaleur du processeur.

Veillez consulter notre section de support contenant la fiche de données de sécurité du modèle SILVGREASE1.

Applications

- Applications très exigeantes, telles que le fonctionnement permanent et hautement performant des processeurs.
- Permet de remplacer la pâte thermique ancienne ou séchée.

Spécifications techniques

- Composé à base de métal contenant de l'oxyde de métal.
- Conductivité thermique de plus de 1,93 W/m-K.
- Conductivité électrique négligeable.
- Performances stables sur une vaste gamme de températures.
- 4 à 6 applications par tube.
- Applicable à seringue refermable.

Spécifications techniques

Warranty	2 Years
Couleur	Argent
Largeur du produit	20 mm [0.8 in]
Longueur du produit	67 mm [2.6 in]
Matériaux	Composé à base de silicone 50 % Composé à base de carbone 30 % Composé à base d'oxyde métallique 20 %
Conductivité thermique	>1.93 W/m-K at 25 °C
Evaporation	<0.001% at 150°C/24 Hours
Fond perdu	<0.05% at 150°C/24 Hours
Gravité spécifique	>1.7 at 25 °C
Résistance thermique	<0.120 °C-in ² /W at 25 °C
Température de fonctionnement	-30°C to 180°C (-22°F to 356°F)
Poids brut	0 kg [0 lb]
Inclus dans le paquet	1 - Tube de 1,5 g de graisse thermique à base d'argent

Certifications, rapports et compatibilité

